



应对全球业务持续增长，慧荣科技宣布新组织架构

December 12, 2023

成立两大业务群，并任命资深高级经理人带领团队成长

台北和美国加利福尼亚讯，2023年12月11日--全球NAND闪存主控芯片领导厂商慧荣科技(NasdaqGS: SIMO)今日宣布新组织架构和领导团队任命，以应对公司全球业务持续增长需求，且变动立即生效。

此次公告的重点是成立终端与车用存储(Client & Automotive Storage; CAS)和企业级存储与显示接口解决方案(Enterprise Storage & Display Interface Solution; ESDI)两大业务群，以建立更明确且专业的组织架构，实现更快速的创新和更强劲的成长，达到为客户提供最佳解决方案的承诺。CAS业务群将负责消费级SSD主控芯片、移动存储主控芯片、Ferri产品和扩展式存储主控芯片。ESDI业务群将负责企业级SSD主控芯片和显示接口产品。

应对新组织架构的需要，慧荣科技在经营团队进行了以下调整：

- 任命原市场营销暨研发资深副总段喜亭(Nelson Duann)为CAS业务群资深副总，负责消费级SSD主控芯片、移动存储主控芯片、Ferri产品和扩展式存储主控芯片的产品规划、OEM业务开发及OEM项目管理。
- 周晏逸 (Alex Chou)加入公司担任ESDI业务群资深副总，负责带领企业级存储团队，将业务扩展到数据中心和企业级存储领域，并将显示接口业务扩展到PC扩展坞市场。
- 原SMI USA总经理Robert Fan 升任为全球业务资深副总暨SMI USA总经理，领导全球销售、FAE和市场公关等团队。

慧荣科技总经理苟嘉章表示：“随着NAND在消费市场、工控、商业和企业级的应用比重不断增加，我们的业务扩展机会也同步成长。通过设立这两个专职业务群，我们将更有能力开发最先进的主控技术，并为客户提供领先业界的解决方案。今天，我们看到了拓展新市场和增加我们现有业务份额的独特机会，通过这样的新架构，我们将可更快、更有效地实现目标，带动长期成长。”

段喜亭自2007年加入慧荣，在半导体行业的产品设计、开发和营销方面拥有近25年的经验。此前，段喜亭负责领导慧荣科技的营销和研发工作，并在领导公司的移动存储主控芯片和SSD主控芯片的OEM业务发展方面发挥了关键作用，协助这两大产品线成为全球领军者。在加入慧荣科技之前，段喜亭工作于Sun Microsystems，专注UltraSPARC微处理器项目。

周晏逸于2023年12月1日加入慧荣科技，在ASIC设计/应用工程、产品营销、业务战略和高管级业务参与方面拥有30多年的行业经验。加入慧荣科技之前，周晏逸任职Synaptics高级副总裁，负责无线连接业务的发展并取得了卓越成功。在此之前，他曾在Broadcom工作了18年多，作为Broadcom无线连接事业部的产品营销副总裁，负责企业网络、WiFi网络解决方案和客户端WiFi/BT/GNSS。

Robert Fan于2013年加入慧荣科技，并担任SMI USA总经理至2023年。在加入慧荣之前，他曾在Spansion、IDT以及两家由创投支持的新创公司担任高管，也曾于Intel任职超过九年，担任销售、营销和管理要职，在职业生涯早期曾是一名芯片设计师。

关于慧荣

慧荣科技(Silicon Motion Technology Corp., NasdaqGS: SIMO)是全球最大的NAND Flash主控芯片供应商，其中SSD主控芯片的出货量全球第一，应用在服务器、PC及其他消费性电子产品。慧荣同时也是eMMC和UFS嵌入式存储主控芯片的市场领导者，应用在智能手机、IoT装置及其他应用。我们同时为超大型数据中心、车载和工控市场提供可定制化、高性能的SSD解决方案。客户包括多数的NAND Flash大厂、储存装置模组厂及OEM领导厂商。更多慧荣相关资讯请访问www.siliconmotion.com

媒体联络人：

林利贞(Minnie Lin)
协理/营销公关部
慧荣科技股份有限公司
Tel: +886-2-2219-6688 ext 3010
E-mail: minnie.lin@siliconmotion.com

许瑜珊(Sara Hsu)
资深项目经理/营销公关部
慧荣科技股份有限公司
Tel: +886-2-2219-6688 ext 3011
E-mail: sara.hsu@siliconmotion.com

投资关系联络人：

谢灵龄(Selina Hsieh)
投资关系
慧荣科技股份有限公司
Tel: +886-3-552-6888 ext 2311
E-mail: ir@siliconmotion.com